

schafft Vorsprung

HEISSLUFT LÖTSTATION 851B+

Hot Air Pencil zum Löten und Entlöten von SMD

Druckluftunabhängig dank der eingebauten sehr leisen aber leistungsstarken Membranpumpe. Kontaktloses, bauteilschonendes Reflow-Löten und Entlöten verhindert Temperaturschocks und Berührung der Bauteile. Dieses kostengünstige aber effiziente Gerät ist ein „Muss“ auf jedem modernen SMT Rework Arbeitsplatz.

Das System 851+ eignet sich zum Löten als auch Entlöten, z.B. von SOIC und CHIP-Bauteilen. Ebenso kann das Gerät für andere feine Arbeiten wie schrumpfen von Schläuchen an unzugänglichen, engen Stellen wie in hochpoligen Steckern eingesetzt werden.

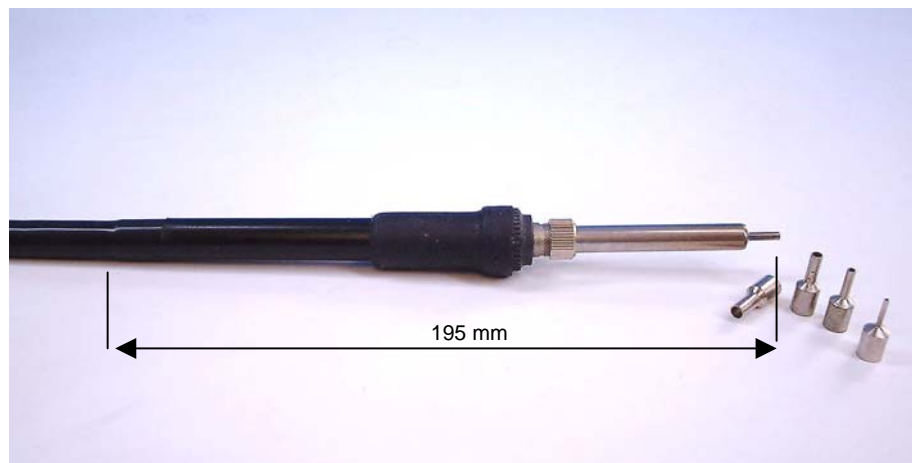


Zum stresslosen
Reflow Löten, auch auf
Keramik Substraten
mit hoher thermischer
Ableitung.

CHF 480.--

- ✓ Stufenlose Einstellung der Temperatur und Luftmenge.
- ✓ Digitalanzeige der Temperatur.
- ✓ Kontaktfreies, bauteilschonendes Löten verhindert Temperaturschocks der empfindlichen Bauelemente.
- ✓ Regelbarer Luftstrom durch integrierte, sehr geräuscharme Hochleistungs-Membranpumpe.
- ✓ Gehäuse und Handgriff sind ESD-sicher. Die Heissluft ist frei von Ladungsträgern.
- ✓ Sehr leichter, ergonomischer Handgriff.
- ✓ 5 Düsen sind im Lieferumfang.
- ✓ Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis.
- ✓ Gemeinsamer flexibler Schlauch für Luft und elektrische Kabel, dadurch sehr handlich im Einsatz.

Der ergonomisch geformte Handgriffel ist nur ca. 50 gr. leicht und liegt sehr gut in der Hand. Der vordere Teil ist mit einem rutschfesten Silikonüberzug ausgestattet.



Im hochflexiblen Anschlusskabel sind die elektrischen Kabel sowie der Luftschlauch integriert. Dies garantiert eine optimale Bewegungsfreiheit. Der Durchmesser des Anschlusskabels beträgt nur 10 mm, die Länge beträgt 1000 mm.

Im Lieferumfang ist das Nozzle-Set mit 5 Heissluftdüsen inbegriffen.

Die Vielfalt der erhältlichen Düsen ermöglicht das Löten und Entlöten von kleinsten Chip-Widerständen, Kondensatoren, Spulen, Dioden usw. von der Bauform 0402 über 1206 bis 2512, von MiniMelf und Melf bis zu TantalC Bauform D.



Ebenso können mehrpolige Komponenten wie Transistoren, Dioden, Widerstands-Arrays, Trimmer usw. problemlos bearbeitet werden.

- A1064 innerer Durchmesser 1,0 mm
- A1065 innerer Durchmesser 1,5 mm
- A1066 innerer Durchmesser 2,0 mm
- A1067 innerer Durchmesser 3,0 mm
- A1068 innerer Durchmesser 3,5 mm

Stromversorgung 851B+ System	230V, 50Hz / 85VA
Heizelement	80W, keramisch
Temperaturbereich – regelbar	150°C bis 500°C
Turbine (Luftpumpe)	langlebige, sehr leise Hochleistungs Membranpumpe
Luftstrom - variabel	0,4 bis 6,5 L/Minute
Gewicht von Handgerät ohne Kabel	ca. 50 gr.
Gewicht	ca. 2,7 kg.
Abmessungen	230 x 145 x 160 mm (TxHxB)
Nozzle-Set mitgeliefert	5 Heissluftdüsen
Ablageständer für Griffel	am Gehäuse integriert

AKTION:

Komplettes Gerät 851B+ mit 5 Heissluftdüsen wie oben beschrieben: **CHF 480.00** (excl. MwSt)

MBR ELECTRONICS GmbH • SOLDER TECHNOLOGY
 JONASTRASSE 8 • CH-8636 WALD • SWITZERLAND
 Internet: www.mbr.ch • E-Mail: info@mbr.ch
 Tel: +41(0)55 246 2400 • Fax: +41(0)55 246 2418

Handgriff

Düsen

Technische Daten

Verkaufspreis